

INHALT

Dezember 2022

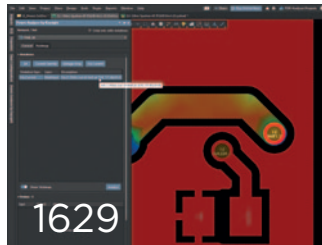


1620

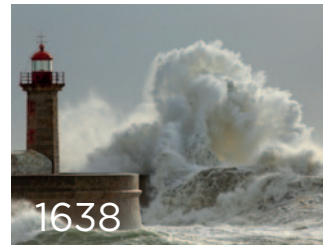
Die ‚electronica 2022‘ in München wurde von Ausstellern wie Besuchern hervorragend aufgenommen und bot reichlich Gelegenheit für fachlichen, geschäftlichen und persönlichen Austausch



Ein neuer Drucktransmitter für industrielle Prozessprotokolle überzeugt mit seinen Werten



Stromverteilung kann im Design durch elektromagnetische Simulation optimiert werden



Der Blick in die Kristallkugel verheißt für das Jahr 2023 nichts Gutes

EDITORIAL

Was für eine Bescherung ... 1601

AKTUELLES

NEWS & Trends 1605

Von glänzender Stimmung und Robotern in Not: electronica 2022 1613

Große Herausforderungen 1619

Die Quadratur des Preises 1620

TERMINE & Events 1625

BAUELEMENTE

Rundsteckverbinder für Single-Pair Ethernet und Automotive Ethernet 1627

BAUELEMENTE

TSN-kompatibler 3-Port-Gigabit Ethernet-Switch für präzise Echtzeit-Kommunikation 1627

Kompakter MEMS-Drucktransmitter für die Prozess-Steuerung 1628

DESIGN

Elektromagnetische Simulationssoftware für Leiterplattendesign 1629

Cloud-basierter Ansys Gateway nutzt Amazon Web Services für intuitives Simulations-Management 1630

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrichkeit): Starkwind in 2023, aber kein Hurrikan? 1638

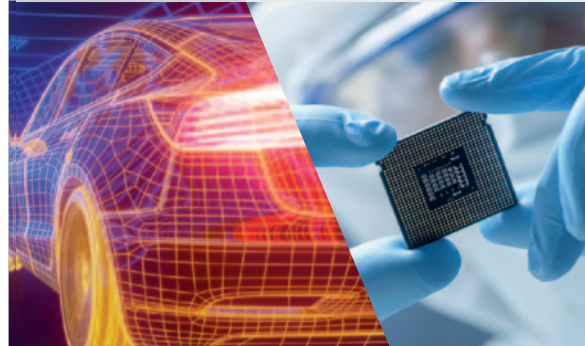
Präzision im Fine-Pitch-Schablonendruck 1644



ventec
INTERNATIONAL GROUP
騰輝電子

Qualitativ hochwertige Basismaterialien und Prepregs

Flexible, zuverlässige Supply-Chain-Lösungen



Ventec International Group

Ventec ist Spezialist für die Herstellung von hochwertigen Basismaterialien und Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz liefert kundenspezifische Supply-Chain-Lösungen in allen Regionen der Welt. Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren in China, Großbritannien, Deutschland und USA, ist niemand besser positioniert, um die Bedürfnisse der globalen Leiterplattenindustrie zu bedienen.



electronica
Besuchen Sie uns:

A1.207



www.ventecclaminates.com



1652

Das Seminar ‚Wir gehen in die Tiefe‘ in Dresden war erneut ein beeindruckendes Forum für Diskussionen und Vorträge



1668

Leiterbahnstrukturen werden immer filigraner – was bei der Impedanzmessung oft zu überraschenden Ergebnissen führt

BAUGRUPPEN & SYSTEME

‚Wir gehen in die Tiefe‘ gab Tipps für die Zukunft 1652

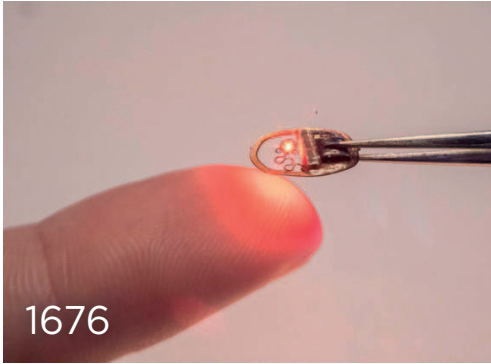
ANALYTIK & TEST

Tappen Sie nicht in die Falle! 1668

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Neues Design von Herzschrittmachern 1676 ▶

PLUS 12/2022 | 1603



An der Universität von Arizona wurde ein Herzschrittmacher entwickelt, der das Herz mit Hilfe von Licht stimuliert

FORUM

Weiterer Mikroelektronik-Paukenschlag in Ostdeutschland	1682
Kolumne: Das ist die alte Adams Rhetoric, daß man die Schuld Gott oder andern Menschen gibt	1692
PLUS-Firmenverzeichnis	1697
Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	1724
Inserentenindex	1725
Mediadaten	1726
Impressum	1727
Gespräch des Monats: Interview mit Robert Jungk	1728

Titelbild

Hochspezialisierte Technologie für Leiterplatten - dies bietet seit dem Jahr 1989 die ALBA PC Group. Die international agierende Firma ist bekannt für ihren exzellenten Service, den die motivierten und qualifizierten Mitarbeitern unter Bündelung ihrer Kompetenzen anbieten. ALBA erzielt durch den Einsatz modernster Produktionstechnologie maximale Geschwindigkeit in der Ausführung und überzeugt mit Know-how, das im Lauf der Jahre erworben wurde. Eigene Fertigungsstätten in Europa und in Asien erlauben im Bereich der Spitzentechnologie die größte Flexibilität bei höchster Qualität.

Weitere Informationen:
T: +49 (0) 6203 95880-0
E: info@alba-pcb.de

www.alba-pcb.de

Die Fachzeitschrift PLUS enthält exklusive Mitglieder-Informationen folgender Fachverbände:



Fachverband Elektronik-Design e. V.
Tel. +49 30 340 60 30 50
info@fed.de, www.fed.de

1632



EIPC – Der Europäische Elektronik-Verband
Tel. +31 46 4264258
www.eipc.org

1643



Fachverband Electronic Components and Systems
Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

1646



Fachverband PCB and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY – Deutschland e. V.
Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

1660



Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V.
Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de

1673



DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.
Tel. +49 211 1591-0
romina.krieg@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

1681